

底面加熱式フィルムコーティングマシン

商品番号: TB08



前書き

セラミック結晶バッテリーやナノフィルム用の底面加熱式フィルムコーティングマシン。コーティング速度調整、精密な厚み制御、真空固定、室温から150℃までの加熱乾燥機能を備え、ラボ研究や材料加工において再現性の高い結果を提供します。

詳細を学ぶ

用途	説明	主な利点
セラミック薄膜研究	セラミックスラリーや機能性セラミック材料を支持基板にコーティングし、高温成膜を研究します。	制御されたコーティング速度と0.01mmの厚み制御により、再現性の高い材料比較が可能です。
結晶フィルム開発	均一なスラリー塗布と制御された乾燥条件が必要な結晶関連フィルムを作製します。	室温から150℃までの底面加熱により、コーティング後の明確な乾燥条件を確立できます。
バッテリー電極作製	ラボでの電極およびセル作製研究のため、アルミ箔や銅箔にバッテリー材料スラリーを塗布します。	真空固定によりコーティング中の基板の動きを抑え、プログラム可能な移動により一貫した電極生産をサポートします。
特殊ナノフィルム研究	精密なブレード調整と制御された動作を必要とするラボコーティングプロセスを用いて、特殊ナノフィルムを開発します。	微細なコーティング制御と速度調整により、プロセス変数を体系的に評価できます。
先端材料研究	高温研究要件下で、新材料の成膜挙動やコーティング条件を調査します。	コーティングと加熱の統合機能により、小規模なプロセス開発を簡素化します。
学術・ラボプロセス研究	材料科学実験、配合スクリーニング、比較試験用に再現性の高いコーティングサンプルを作製します。	タッチスクリーンによるパラメータ設定、コンパクトな寸法、自動コーティング動作がワークフロー効率を向上させます。

パラメータ	仕様
モデル	TB08
標準コーティングデバイス幅	100 mm
真空プレート	真空アルミフラットプレート付属
付属真空ポンプ	オイルフリー真空ポンプ1台
制御システム	PLCおよびタッチスクリーン制御
コーティングストローク設定	0～300 mm（タッチスクリーンで設定）
電源	220 V / 50 Hz
重量	50 kg
全体寸法	L550 mm × W350 mm × H320 mm

パラメータ	仕様
-------	----

コーティング速度	0～120 mm/s（調整可能）
ブレード厚み調整範囲	0～5 mm
コーティング厚み制御精度	0.01 mm
真空プレート加熱・乾燥システム	室温～150℃
温度コントローラー	デジタル表示温度コントローラー
温度制御精度	±1℃
真空プレート寸法	L415 mm × W200 mm × H32 mm

基板	幅	厚み	坪量
アルミ箔	50～200 mm	10～50 μm	27～135 g/m ²
銅箔	50～200 mm	6～20 μm	53～178 g/m ²

ステップ	操作
1	電極シートを真空プレートに置き、電源を入れ、真空を有効にして電極シートをプレートに固定します。
2	コーティングデバイスを電極シート上に配置し、コーティングスラリーを追加します。
3	コーティングサイクルを開始します。コーティングデバイスが自動的に前進し、コーティング操作を完了します。
4	コーティングデバイスとプッシュロッドを取り外し、加熱温度と時間を設定して加熱乾燥を行います。
5	乾燥完了後、コーティングされた電極シートを取り外し、コーティングデバイスをリセットします。